



平成24年3月期 決算説明会

説明者

代表取締役社長	種村	均
取締役執行役員財務部長	加藤	博



本日の内容

1. 平成24年3月期
連結決算の概要
2. 平成25年3月期
連結業績予想と重点政策

連結子会社

連結 20社 減少3社

(株)ノリタケボンデッドアブレーション

(株)ノリタケスーパーアブレーション

(株)ノリタケデンタルサプライ

持分法 4社 増加1社

クラレノリタケデンタルホールディングス(株)

連結決算の概要

(単位：億円)

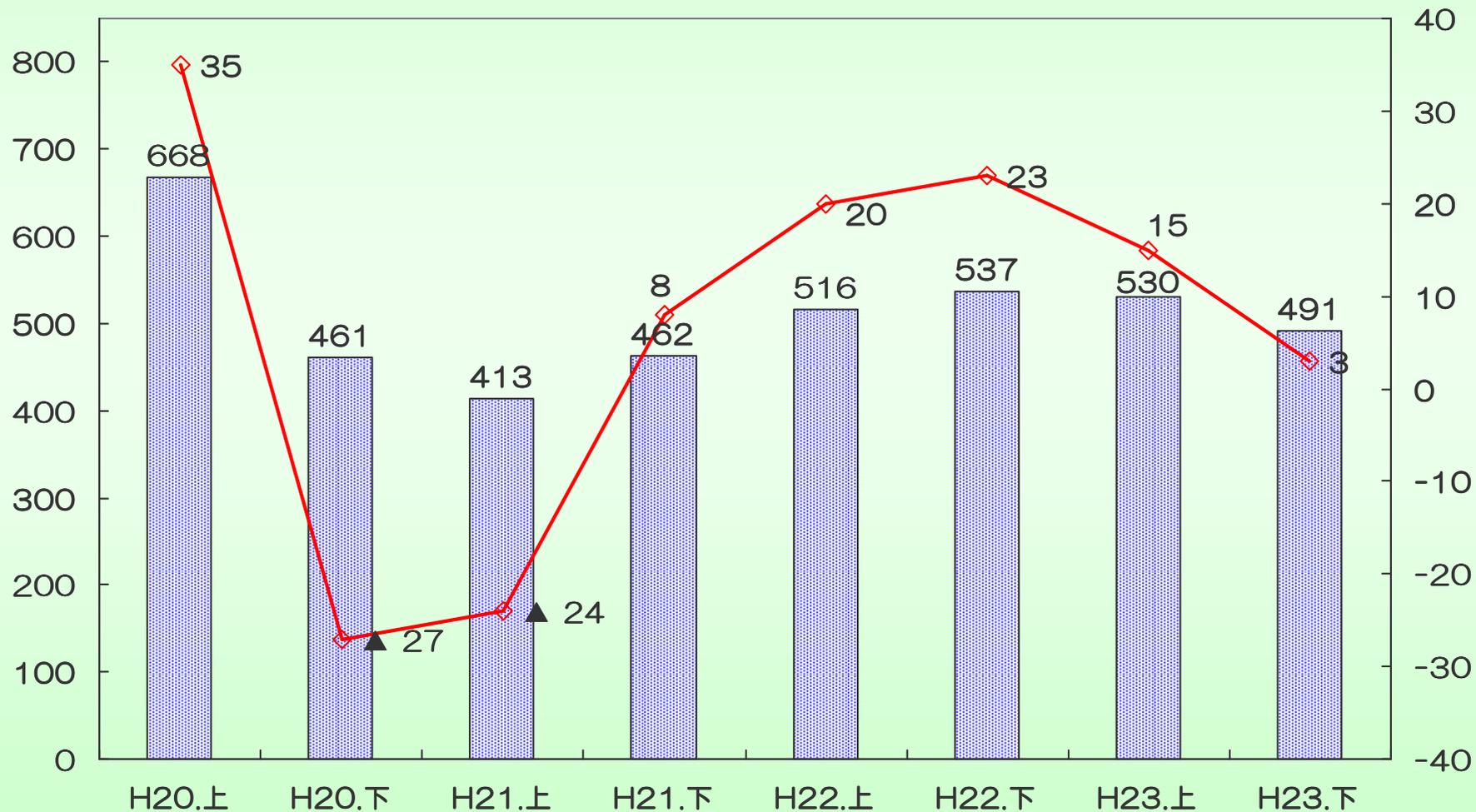
	H23/3	H24/3	前年同期比
売上高	1,054	1,022	△3.1%
営業利益	43	19	△56.5%
経常利益	48	27	△44.4%
当期利益	19	45	+140.4%
1株利益	13.16円	31.99円	
配当	5円	8円	

4

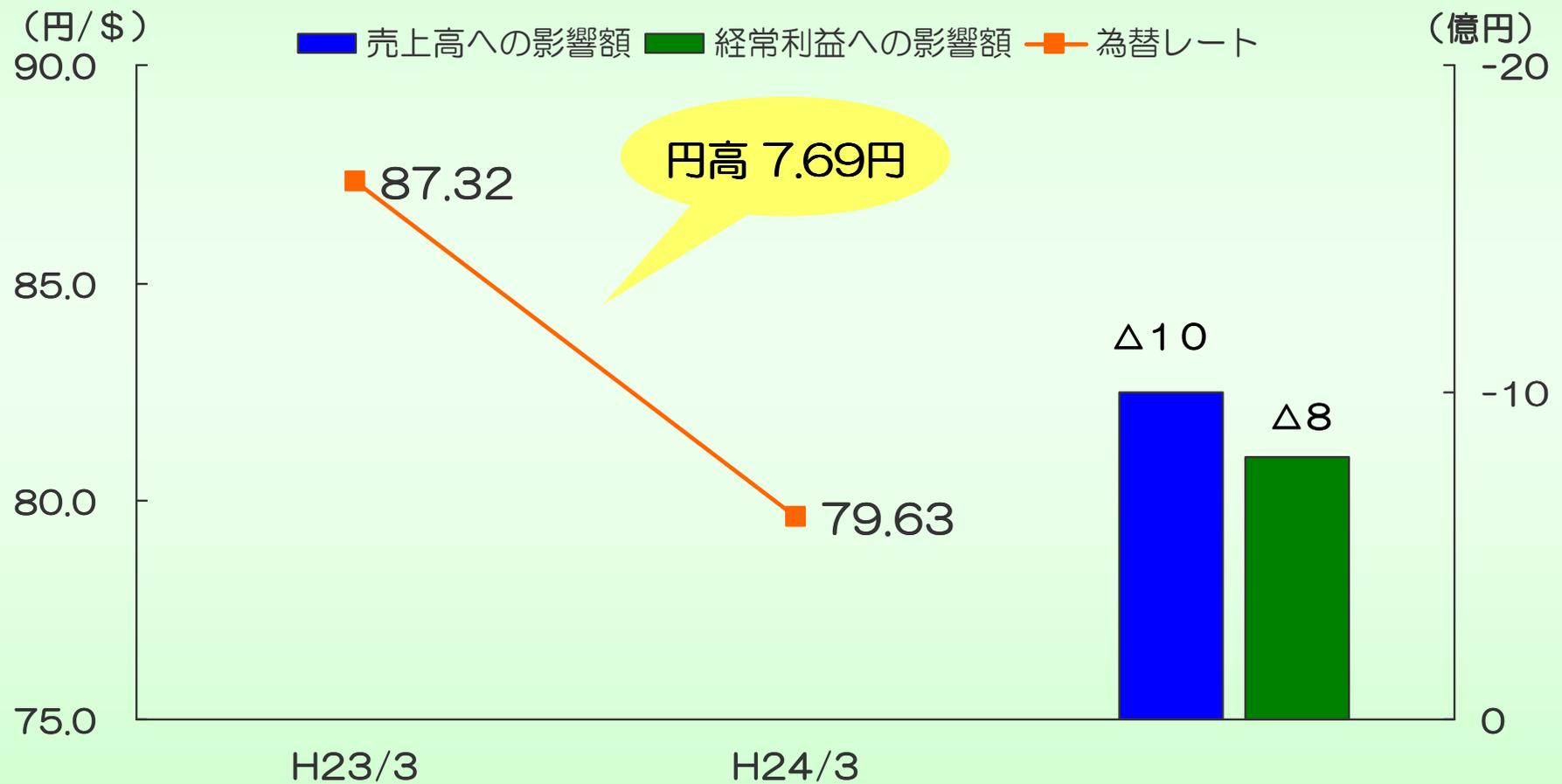
連結損益の推移

■ 売上高 (左軸 億円)

◇ 営業利益 (右軸 億円)



為替の影響



連結経常利益の変動要因

H23年3月期 経常利益 48億円



増加要因	14億円
合理化・改善の効果	10億円
一般管理費・販売費の減少	3億円
持分法投資損益	1億円
減少要因	36億円
売上高の減少	12億円
為替の影響	8億円
原材料価格の上昇	10億円
工場移転費用	2億円
デンタル子会社の連結除外	4億円

H24年3月期 経常利益 27億円

* 本社への製造子会社統合に伴い技術部門の一部が製造勘定に組み入れられた影響額14億円を除く。

特別損益

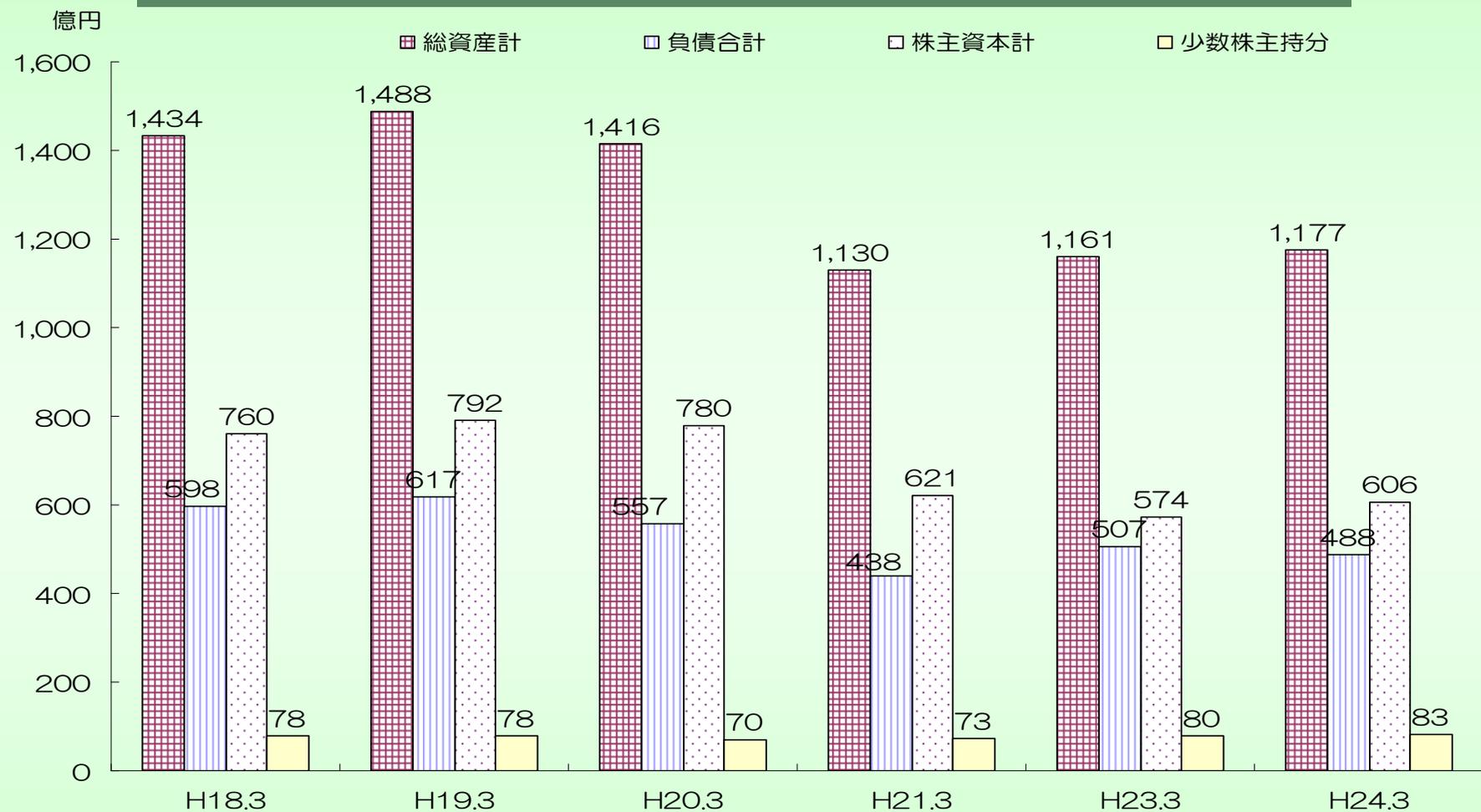
(特別利益)		<u>40.7億円</u>
内訳	固定資産売却益	30.4億円
	持分変動損益	9.9億円
	その他	0.5億円
(特別損失)		<u>△7.9億円</u>
内訳	固定資産処分損	△6.4億円
	固定資産減損損失	△1.3億円
	その他	△0.3億円

比較貸借対照表

(単位：億円 未満切捨)

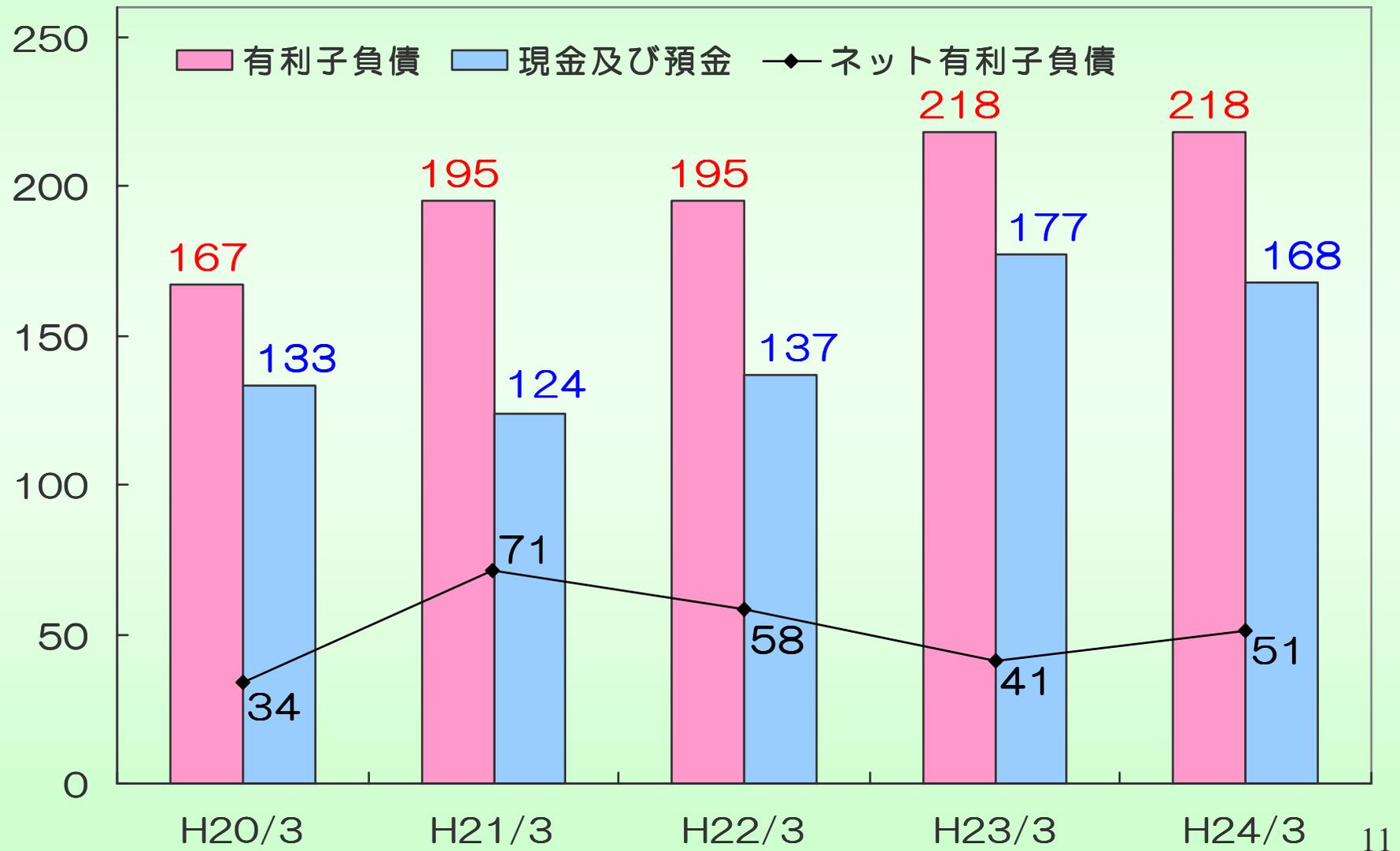
	H23/3	H24/3	増 減
総 資 産	1,161	1,177	16
流動資産	653	638	△15
固定資産	508	539	31
負 債	507	488	△19
純 資 産	654	689	35
(内、少数株主持分)	(80)	(83)	(3)
一株当り純資産	411 円	434 円	23 円

貸借対照表残高の推移



	H19.3	H20.3	H21.3	H22.3	H23.3	H24.3
株主資本比率	53.3%	55.1%	55.0%	54.2%	49.5%	51.5%

有利子負債残高



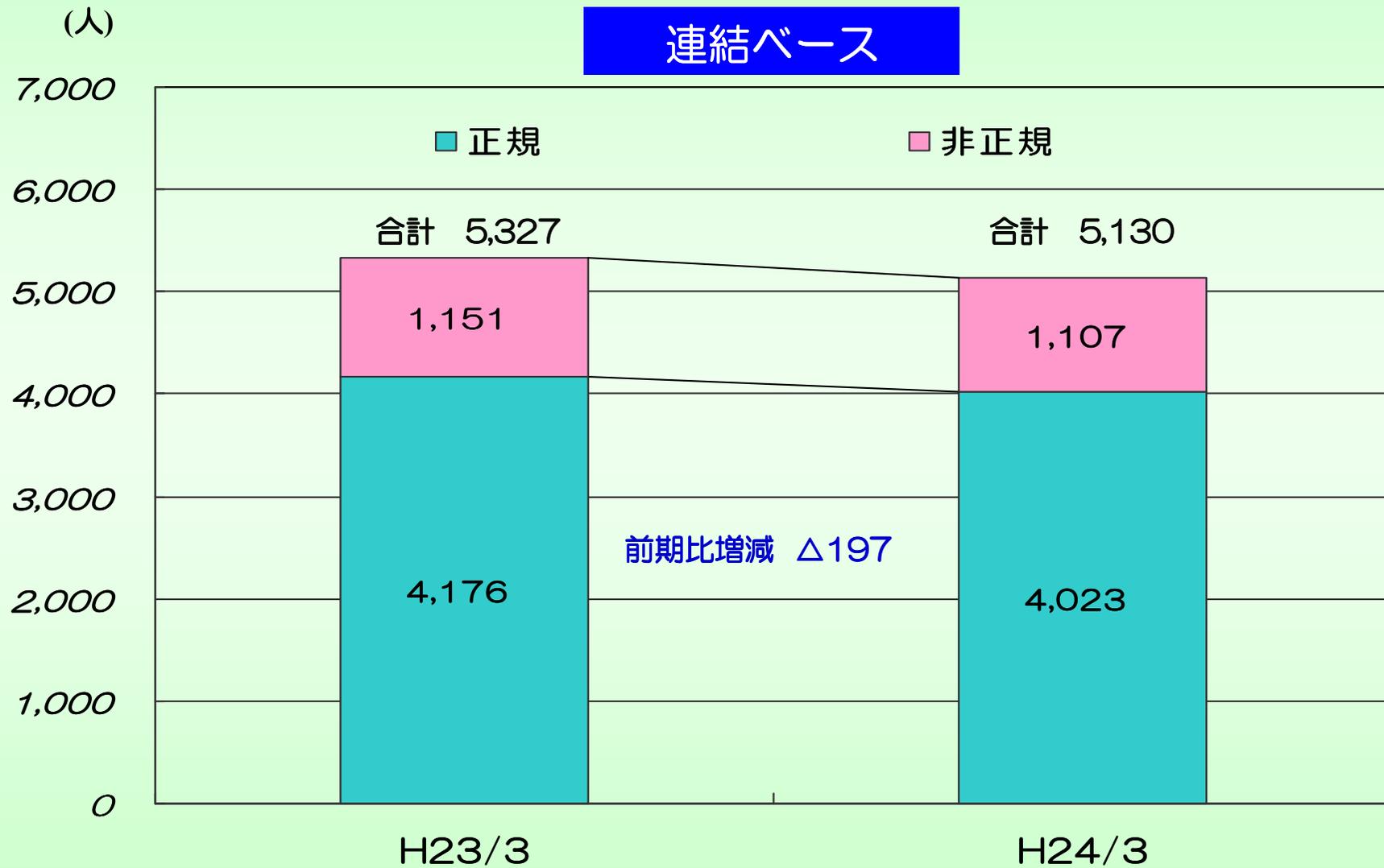
キャッシュフロー

(単位：億円)

	H23/3	H24/3	増 減
営業活動によるCF	73	33	△40
(内、法人税等)	(△7)	(△11)	(△4)
投資活動によるCF	△38	△41	△3
フリーキャッシュフロー	35	△8	△42
財務活動によるCF	7	△10	△17
(内、長短借入金純増減)	(△77)	(△0)	(△77)
現金及び同等物残高	158	138	△20

期末人員数

連結ベース



セグメント別動向

— 事業概況 —

工業機材

研削砥石 ダイヤ・CBN 工具 研磨布紙

セラミック・マテリアル

電子ハート
セラミック資材

厚膜回路基板
蛍光表示管

デンタル・石膏
共立マテリアル

エンジニアリング

乾燥・焼成炉 濾過装置 研削機械等

食器

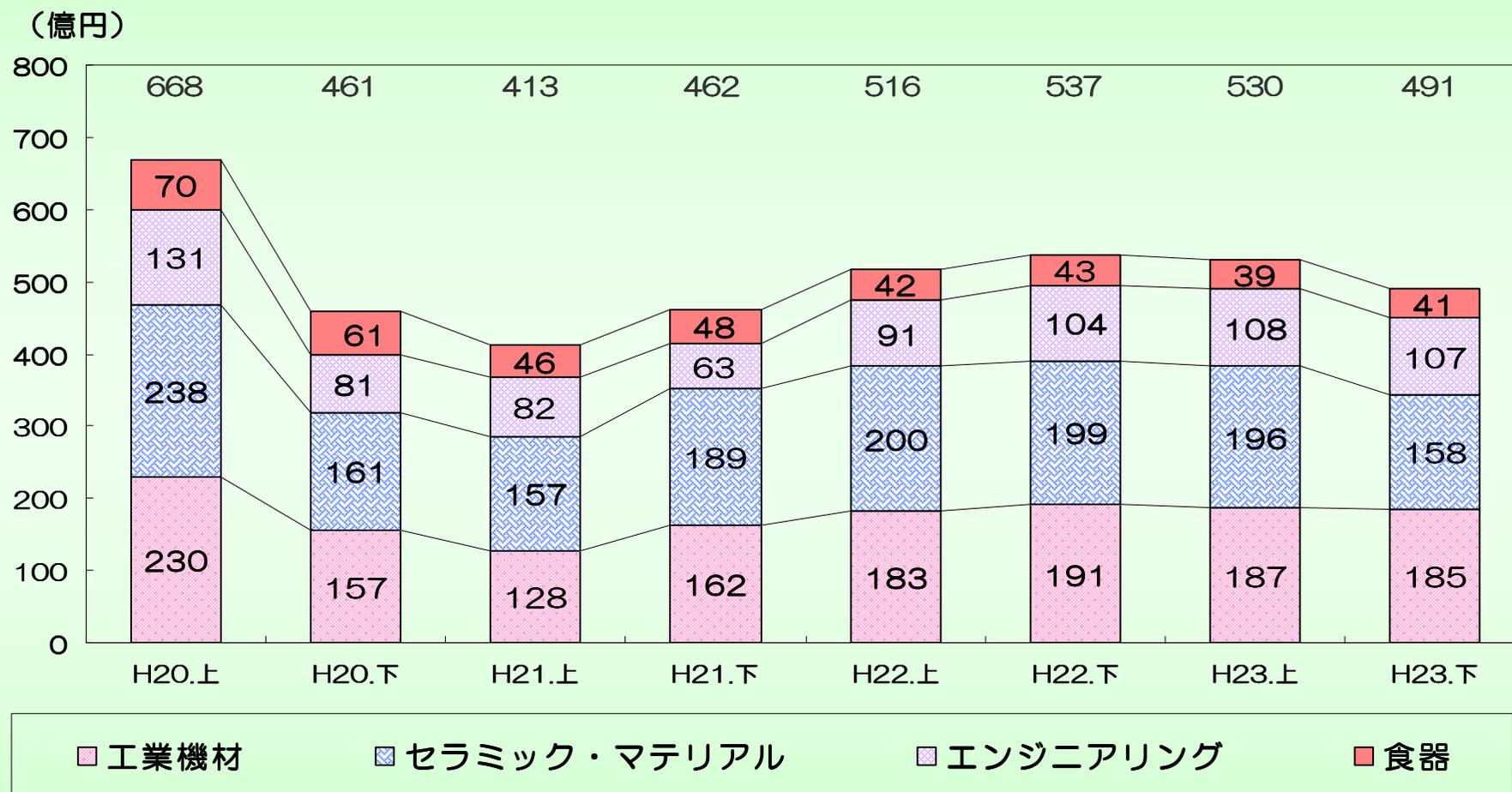
米州 欧亜 国内

セグメント別売上高（前年度比較）

（単位：億円）

	H23/3	H24/3	前期比
工業機材	374	372	△0.6%
セラミック・マテリアル	399	355	△11.1%
エンジニアリング	195	215	9.8%
食器	85	80	△5.5%
合計	1,054	1,022	△3.1%

セグメント別売上高推移



セグメント別営業利益

(単位：億円)

	営業利益		営業利益率	
	H23/3	H24/3	H23/3	H24/3
工業機材	13.3	9.0	3.5%	2.4%
セラミック・マテリアル	39.1	19.1	9.8%	5.4%
エンジニアリング	△1.8	△2.7	△0.9%	△1.2%
食器	△7.3	△6.7	△8.6%	△8.3%
計	43.3	18.8	4.1%	1.8%

工業機材事業

(単位：億円)

売上高	H23/3	H24/3	前期比
研削砥石	145	146	1
ダイヤ・CBN 工具	122	121	△1
研磨布紙	69	66	△3
関連商品	38	39	1
合計	374	372	△2

18

セラミック・マテリアル事業

(単位：億円)

売上高	H23/3	H24/3	前年同期比
電子ペースト	98	114	16
セラミック部品	27	24	△3
デソル・石膏	41	19	△22
厚膜回路基板	25	27	2
蛍光表示管	63	49	△14
共立セラミック原料	76	77	1
共立電子部材	69	45	△24
合計	399	355	△44

エンジニアリング事業

(単位：億円)

売上高	H23/3	H24/3	前期比
乾燥・焼成炉	153	164	11
濾過装置	18	22	4
研削機械	13	17	4
スタティックミキサー等	11	12	1
合 計	195	215	20

食器事業

(単位：億円)

売上高	H23/3	H24/3	前期比
米州	19	18	△1
欧亜	19	19	0
国内	47	43	△4
合計	85	80	△5

本日の内容

平成25年3月期
連結業績予想と重点政策

平成25年3月期 連結業績予想

(単位：億円)

	H24/3			H25/3				
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	通期増減	増減率
売上高	530	491	1,022	505	535	1,040	18	+1.8%
営業利益	15	3	19	8	19	27	8	+43.6%
経常利益	20	7	27	13	22	35	8	+30.0%
特別損益	36	△3	33	0	0	0	△33	—
税前利益	56	4	60	13	22	35	△25	△41.4%
当期利益	46	△1	45	8	17	25	△20	△44.0%
US\$為替	80円			80円				

連結経常利益（予想）の変動要因

H24年3月期 経常利益 27億円



増加要因	15億円
売上高の増加	6億円
合理化・改善効果	8億円
持分法投資損益	1億円
減少要因	7億円
原材料価格の上昇	5億円
工場移転費用	2億円

H25年3月期 経常利益 35億円

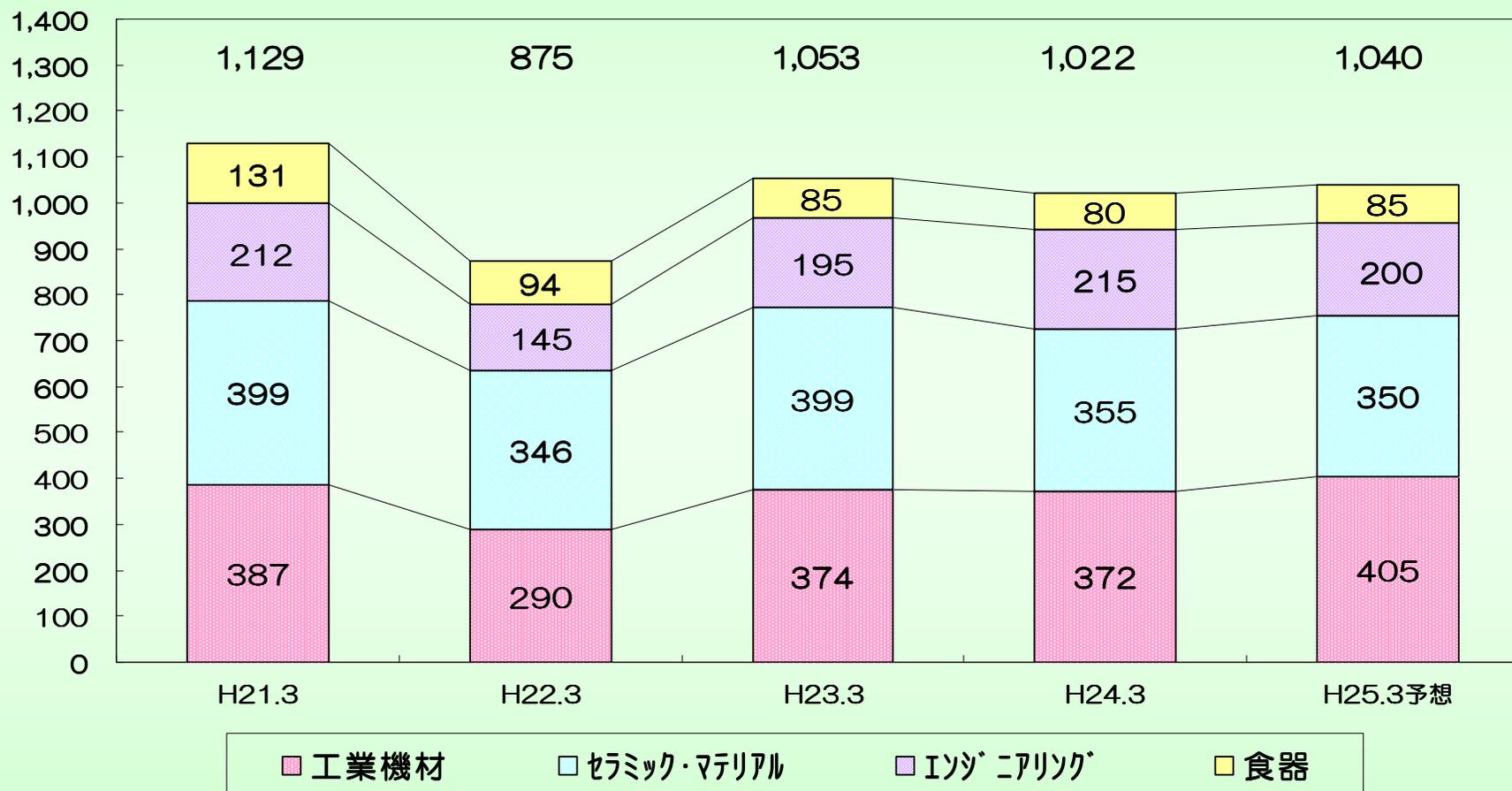
セグメント別業績予想 (前年度比較)

(単位：億円)

	H24/3		H25/3		増 減	
	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益
工業機材	372	9.0	405	11.0	33	2.0
セラミック・マテリアル	355	19.1	350	17.0	△5	△2.1
インダストリアル	215	△2.7	200	3.0	△15	5.7
食 器	80	△6.7	85	△4.0	5	2.7
合 計	1,022	18.8	1,040	27.0	18	8.2

セグメント別売上高推移

(億円)



平成25年3月期の重点政策

1. 新商品の開発・拡販
2. 海外事業の拡大
3. 経営体質の強化

新製品の開発・開拓

戦略商品の売上状況

(億円)

	H23.3期 実績	H24.3期 実績	H25.3期 予定
太陽電池ペースト	35	63	54
ダイヤモンドワイヤー	1	3	6
リチウム電池焼成炉等	47	66	40
合計	83	132	100

- ・ 太陽電池ペーストの25年3月期予定は数量では10%増
- ・ 太陽電池業界の在庫調整が進みつつあり、後半に期待
- ・ ダイヤモンドワイヤーは、コスト削減で競争力を高める
- ・ リチウム電池焼成炉は、国内一服で海外販売に注力

海外事業の拡大

セグメント別の海外事業比率

金額ベース：％	海外販売		海外生産	
	24年3月期 実績	25年3月期 予定	24年3月期 実績	25年3月期 予定
工業機材	21	22	2	4
セラミック・マテリアル	48	48	20	22
IT・プリンタ	34	40	10	12
食器	48	48	41	46
合計	35	37	12	14

- ・ 海外生産比率が海外販売比率を大きく下回る現況
- ・ 円高もあり海外販売の採算と競争力が低下
- ・ 長期的に販売・生産共に50%にする目標
- ・ 特に工業機材の海外展開が急務

海外事業の拡大

25年3月期に稼動する海外工場

単位：億円	設備投資	操業開始	生産能力	25年3月 期生産
①中国鉄鋼用砥石	10	24年10月	8	1
②タイ電着ダイヤモンド	8	24年8月	7	1
③タイ石膏増産	9	24年6月	8	5
④米国CBN砥石	2	24年9月	5	3
合計	29		28	10

経営体質の強化への取組み

- ① ものづくり強化活動の展開
- ② 環境経営の取組み強化
- ③ 内部統制・管理システム整備
- ④ 耐震対策の強化、リスク分散
- ⑤ 本社工場の移転・再配置

ご清聴有難うございました。

Noritake

本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。

こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。

将来の業績は、経営環境の変化などによって、計画と異なる可能性があることにご留意ください。